わが社の「ひとわざ（一技）」PRシート

分類No.：4．電子製造・組立
登録No.：4－6001

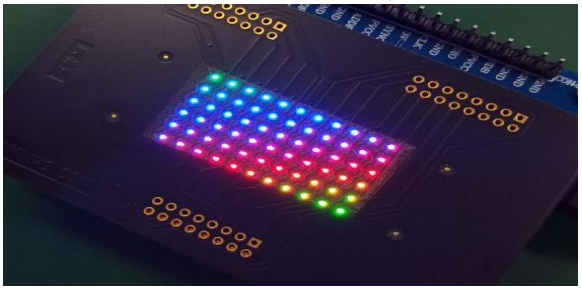
ひとわざ（一技）名：　半導体ﾍﾞｱﾁｯﾌﾟ実装・ﾌｨﾙﾑ曲面貼合・製品組立

1．概要

○半導体ベアチップ実装(ワイヤーボンディング、フリップチップボンディング）及び液晶などのフラットパネルディスプレイ関係の実装とフィルム貼合、曲面へのフィルム貼合及び電子機器、光学機器の製品組立を受託しております。量産の他、試作の受託も承っております。
・半導体ベアチップ実装：ICチップの他、ミニLEDやUV-LED、PD、バイオチップ実装に実績多数
・フィルム貼り合わせ：平面、2.5D曲面の他、3D曲面への貼り合わせ技術を開発中
・組立：弊社実装部門と連携した製品組立の他、産機、医療、光学機器の量産製品組立実績多数

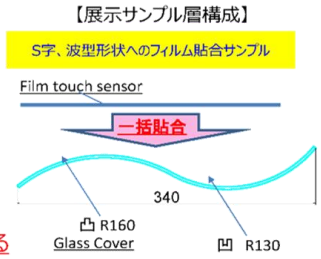
写真・図（要点説明）

青色チップサイズ0.2x0.38mm　実装ピッチ2.54mm



RGBチップサイズ0.1x0.2mm　実装ピッチMin0.2mm

当社では、様々な曲面形状に対応した貼合技術の開発を推進しております。
➢接着材料：OCA
➢曲面形状：凸型、凹型
➢対応曲率：R130まで
➢対応サイズ：300×450㎜



選択性の高い貼合技術でディスプレイ関連機器の更なるデザイン性UPに貢献致します!!

2．企業概況

フリガナ	カブシキガイシャ　イングスシナノ			フリガナ	コバヤシ　ヒデトシ		
会社名	株式会社　イングスシナノ			代表者名	小林　秀年		
				フリガナ	エイギョウギジュツグループ		
				窓口担当	営業技術グループ		
事業内容	電子デバイス及び情報機器の製造			URL	www.ings-s.co.jp		
主要製品	半導体実装組立、フラットパネルディスプレイ実装組立、光学機器組立						
フリガナ	ナガノケン　スワグン　シモスワマチ　キタシオウ						
住所	〒393-0042　長野県諏訪郡下諏訪町北四王5415						
電話/FAX	0266-27-8056 / 0266-28-0325			E-mail	ings-shinano@ings-s.co.jp		
資本金（百万円）	20	設立年月	1946年	売上（百万円）	1,000	従業員数	80

特記事項（①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③SDGsへの取り組み　他
①ISO9001、ISO14001、IATF16949認証取得済　医療機器製造業登録、ソニーグリーンパートナー認証
②半導体ベアチップ実装を要する電子デバイスの試作、量産と組立。
液晶、有機ELなどフラットパネルディスプレイ関連の実装とタッチセンサーフィルムなどの高精度貼り合わせの試作、量産と組立及び平面の他曲面へのフィルムの貼り合わせ。電子デバイス機器の他、光学機器等の製品組立。